

Technisches Merkblatt HECK K+A LIGHT 085

HECK K+A LIGHT 085:

Werk trockenmörtel mit PWS-Technologie, mineralischer Klebe- und Armierungsspachtel, LW, CS III, W2 nach DIN EN 998-1

Eigenschaften:

- von Hand aber auch mit Putzmaschinen und Förderanlagen zu verarbeiten
- wasserdampfdiffusionsoffen und wasserabweisend
- faserarmiert
- filzbar
- Farbton: weiß
- hochergiebig
- ultraleicht

Anwendungsbereich:

- für Außen- und Innenbereich, sockeltauglich
- zum Kleben und Armieren von Dämmplatten in HECK Dämmsystemen
- zum Ansetzen von Eck- und Diagonalarmierungen geeignet.
Die Regelauftragsdicken müssen eingehalten werden. Dies gilt auch für den Bereich der Eckarmierungen.

Anwendung in Wärmedämm-Verbundsystemen:

- als Klebemörtel für Dämmplatten mittels Wulst-Punkt-Verklebung (Klebeflächenanteil $\geq 40\%$), Vollflächenverklebung oder Bauteilverfahren (Klebeflächenanteil $\geq 60\%$)
- als Armierungsspachtel (3 - 10 mm) mit Einbettung von HECK Armierungsgewebe fein (auf WDV-Systemen und ähnlichen Untergründen zwingend erforderlich)

Für darüber hinausgehende Verwendungen haftet der Anwender selbst.

Zusammensetzung:

Weißkalkhydrat, Zement, gewaschene Quarzkörnung, Leichtzuschläge, Zusatzmittel zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit, Haftfestigkeit und Wasserabweisung, alkalistabile Glasfasern

Technische Daten:

Größtkorn:	1,0 mm
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert):	0,44 W/(m·K)
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ :	20
Wasseraufnahme nach ETAG 004:	W < 0,5
Wasseraufnahmekoeffizient nach EN 1015-18: 2002:	W2; c < 0,2 kg/(m ² min ^{0,5})

Verbrauch:

Kleben:

Punktverklebung (Schienensystem):	ca. 1,5 kg/m ²
Wulst-Punkt-Verklebung:	ca. 3 kg/m ²
Bauteilverfahren (Teilverklebung)*:	ca. 4,5 kg/m ²
Vollflächenverklebung (Vollverklebung)*:	ca. 6 kg/m ²

*Kleberauftrag auf das Mauerwerk

Die Angaben gelten für ebene, glatte Untergründe. Beim Ausgleich von Unebenheiten Mehrverbrauch möglich!

Armierungsmörtel:

ca. 0,85 kg Trockenmörtel / m² je mm Schichtdicke

Bei maschineller Verarbeitung Mehrverbrauch möglich!

Putzgrund/

Putzgrundvorbereitung:

Arbeitsbereich unbedingt vor Beginn der Arbeiten gut abdecken.

Kleben der Dämmplatten auf mineralischen Untergrund:

Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sein. Eine Reinigung wird empfohlen. Mürber oder hohl liegender Putz oder lose anhaftende Farbreste sowie Algen sind grundsätzlich zu entfernen.

Hohlfugen, Mauerwerksfehlstellen und größere Vertiefungen vor dem eigentlichen Kleber- bzw. Putzauftrag egalisieren, oberflächenbündig abziehen und während des Ansteifens aufkämmen und erhärten lassen.

Oberflächlich sandende, kreidende, stark saugende, organisch gebundene Untergründe einmal mit Rajasil TG W (Tiefengrund W) vorbehandeln.

Armierung auf Dämmplatten:

Die Dämmplatten müssen eben verlegt sein, offene Plattenfugen müssen mit gleichwertigem Dämmstoff oder PU-Schaum B1 geschlossen sein, evtl. Schleifstaub muss entfernt sein.

Profile, Dübel, Fugendichtbänder und Anputzleisten müssen gesetzt sein, ebenso die Eck- und Diagonalarmierungen.

Ein Untergrundaussgleich mit der Armierungsschicht ist nicht zulässig.

Verarbeitungs- und Untergrundtemp.:

mindestens + 5 °C. Ein Unterschreiten der Temperaturen während der Erhärtungsphase kann die Produkteigenschaften nachhaltig ungünstig beeinflussen.

Verarbeitung:

Bei hohen Temperaturen (und/oder Windbelastung) sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich um zu schnellen Anmachwasserentzug zu verhindern.

Die Inhalte eines Sackes mit der erforderlichen Menge Leitungswasser in einem sauberen Mörtelkübel mit einem Motorquirl knollenfrei anrühren, ca. 10 Minuten reifen lassen, vor dem Auftragen nochmals gut durchmischen und innerhalb von ca. 1 Stunde verarbeiten.

Kleben:

Bei unbeschichteten MW-Dämmplatten ist der Klebemörtel vorher dünn unter Druck vorzuziehen (sog. Pressspachtelung). Der Klebemörtel ist dann mittels Zahntraufel (10 mm) bzw. Kelle oder mit der Klebepistole auf der Dämmplattenrückseite aufzutragen, beim teil- oder vollflächigen Klebverfahren auf das Mauerwerk zu spritzen.

Bei Klebarbeiten im Deckenbereich sind Vorversuche erforderlich. Es ist hierbei festzustellen, ob zusätzliche Maßnahmen, wie z.B. eine Dübelung oder ein Abstützen bis zum Erhärten, erforderlich sind.

Armieren:

Der Mörtel wird mit einer rostfreien Stahltraufel in entsprechender Dicke auf die (trockenen) Dämmplatten aufgebracht. Anschließend wird das HECK AGG FINE (Armierungsgewebe fein) im oberen Drittel eingebettet (Gewebeüberlappung mind. 10 cm), ggf. wird nochmals nachgespachtelt.

Für den nachfolgenden Auftrag dünnlagiger Oberputze wird die Oberfläche mit der Edelstahltraufel eben abgezogen. Für nachfolgendes Filzen wird der Untergrund so belassen. Für dicklagige Edelputze erfolgt ein Aufrauen der Oberfläche ohne das Gewebe freizulegen. Das Aufrauen darf erst nach Bildung der Sinterhaut erfolgen.

Nachbehandlung:

Der frische Mörtel muss vor zu schnellem Wasserentzug (Sonne, Wind, hohe Temperaturen), Frosteinwirkung und Regen geschützt werden. Beim Verkleben ist dieser vor Hinterfeuchtung zu schützen.

Oberflächenbeschichtung:

Mit mineralischen oder organischen HECK Oberputzen.

Vor nachfolgender Beschichtung ist je nach Oberputz die ggf. zugehörige Grundierung zu verarbeiten. Standzeit vor Grundierung bzw. Oberputz oder der gewünschten keramischen Bekleidung: je nach Witterung mind. 1 Tag je mm Schichtdicke.

Im Sockelbereich:

- Rajasil Siliconharzfarbsystem, bestehend aus zweimaliger Grundierung mit Rajasil NIG und zweimaligem Anstrich mit Rajasil SHF (Siliconharzfarbe).
- HECK SHP (Siliconharzputz) einschl. der dazugehörigen Grundierung (UG (Universalgrundierung)).

Das in den Perimeterbereich einbindende Putzsystem ist gegen eine Hinterfeuchtung zu schützen. Hierbei ist Rajasil DB (Dickbeschichtung) oder Rajasil DS FLEX (Dichtungsschlämme flexibel) zu verwenden.

Hinweise:

Bitte "Verarbeitungsrichtlinien HECK" bzw. ergänzende Merkblätter relevanter Produkte beachten.

Beim Verputzen von EPS-Platten mit Oberflächenwaffelung (Rille) ist der Mörtel zweischichtig aufzubringen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei der Herstellung von WDV-Systemen sind die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen zu beachten. Diese sind auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:

Das Produkt enthält Kalk und Zement, frischer Mörtel reagiert daher alkalisch.

Kontakt mit der Haut vermeiden, Spritzer sofort abwaschen. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen.

Das Material darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Verschlucken unverzüglich Arzt konsultieren.

Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerung:

trocken, Lagerdauer ca. 9 Monate

Qualitätskontrolle:

Eigen- und Fremdüberwachung der Produkte



Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus. Mit dieser Ausgabe sind die früheren Technischen Merkblätter ungültig.

HECK Wall Systems GmbH
Thörlauer Straße 25
95615 Marktredwitz / Germany
T: +49 9231 802-0
F: +49 9231 802-330
www.wall-systems.com